

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

广州方邦电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他_
参与单位名称	广发证券、创富兆业、兴业证券、长江证券、国投证券、华美国际投资、泓屹资产、泓毅投资、德毅资产、奶酪基金、汇川投资、航电投资、珠海聚亿、汇添富等
时间	2025 年 6 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：苏陟 董事、核心技术人员、首席技术官：高强 董事会秘书：王作凯
投资者关系活动主要内容介绍	一、关于电磁屏蔽膜产品的相关情况 公司电磁屏蔽膜业务在 2025 年上半年受益于消费电子市场复苏，订单情况良好。当前，随着折叠屏手机、AI 手机的兴起与发展，对电磁屏蔽材料提出更薄、更耐弯折、高导热等更高要求，公司正加快产品迭代升级，努力抢占下一代智能终端电磁屏蔽解决方案的技术制高点。 柔性屏蔽罩可视为屏蔽膜的“升级款应用”，主要用于智能手机等“轻薄短小”电子产品内部组装的高断差场景，目前公司柔性屏蔽罩已应用于相关智能手机终端，用以取代其内部金属屏蔽罩，该类产品目前尚未成为主流技术方案，但符合电

	子产品“轻薄化”趋势，体现出较好的未来增长潜力。 二、关于带载体可剥离超薄铜箔产品的进展 公司带载体可剥离超薄铜箔主要应用于 IC 载板和类载板。截至目前，该产品相关型号陆续通过了多家下游客户的测试认证，持续获得小批量订单，并在与客户的应用沟通反馈过程中持续提升产品质量和稳定性，逐步突破“从 0 到 1”的最艰难阶段，未来 1-2 年内订单起量有望加快。 根据市场研究及相关数据，当前可剥铜的全球市场规模约为 50 亿元/年，多年来基本被日本三井金属垄断，随着 AI 技术的发展，对先进芯片的需求不断增加，将推动可剥铜市场持续增长。在当前中美关税、技术博弈、国内供应链加速本地化的背景下，一定程度上有利于加快公司可剥铜产品的国产替代进程，逐步获取更多的市场份额。 三、关于 FCCL 产品的发展策略及核心竞争力 公司大力推进挠性覆铜板（FCCL）业务，“原材料自研自产”战略逐步深入，目前，使用自产铜箔生产的 FCCL 产品已实现规模销售，预计 2025 年全年销售收入将较大幅度增长，成为公司新的业绩增长极。同时，公司使用自产铜箔+自产 PI/TPI 为原材料生产的 FCCL 产品也在持续送样认证中，可进一步提升 FCCL 业务盈利能力。 FCCL 行业市场竞争充分，依托于对超薄高频铜箔技术、PT/TPI 配方技术的良好布局，公司可实现 FCCL 产品原材料的自研自产，一方面可逐步摆脱对上游供应商的依赖，另一方面可较好降低生产成本、提升产品竞争力。公司在 FCCL 业务的规划是对标美国 DuPont、日本 Nippon Steel、韩国 NexFlex 等高成长、高盈利能力企业，坚定发展成为国内头部、全球前十的 FCCL 研发生产商。
--	---

	四、关于薄膜电阻、热敏型薄膜电阻产品的进展及未来规划 公司薄膜电阻产品主要应用于电子产品声学模块，当前已通过部分客户验证，持续获得批量订单，后续订单进一步起量趋势良好。薄膜电阻亦称埋阻铜箔，将电阻埋入线路板内部线路，实现更高精度的阻值，同时可因取消传统焊点而提升信号稳定性，因此可应用于低轨卫星等航空航天场景，该场景的应用目前正处于相关客户的测试流程中。 热敏型薄膜电阻可随温度的变化而呈现阻值变化，适用于电子产品内部的芯片热管理。随着新能源汽车、AI 技术的高速发展，芯片制程愈加先进，运算速度愈加高速化，由此带来了愈加广泛而严重的芯片发热、散热问题。热敏型薄膜电阻植入于芯片焊脚，可及时、精确地感知芯片温度细微变化，进而通过软硬件的设计来实现芯片的主动热管理。热管理是新一代电子产品必须解决的普遍而迫切问题，该产品在国内某知名电子产品终端的上百个创新项目中名列前茅，具有良好的应用前景和市场需求，目前该产品正处于相关客户的测试流程中。 五、关于公司对未来的展望 经过近几年的布局和辛勤耕耘，公司 FCCL、可剥铜、薄膜电阻（含热敏型）等新产品陆续取得良好进展，逐步突破“从 0 到 1”的最艰难阶段，叠加在电磁屏蔽膜领域，公司出货量已稳居全球前列，并积极拓展新应用方向和新客户，以上因素将推动公司迈入新的发展阶段、取得新的业绩高点。 以上预测具有不确定性，不构成投资承诺，敬请理性决策、注意投资风险。
附件清单(如有)	